

EVG610 单面/双面光刻机



一、简介

EVG 公司成立于 1980 年, 公司总部和制造厂位于奥地利, 在美国、日本和台湾设有分公司, 并在其他各地设有销售代理及售后服务部, 产品和服务遍及世界各地。

EVG 公司是一家致力于半导体制造设备的全球供应商, 其丰富的产品系列包括: 涂胶和喷胶/显影机/热板/冷板、掩模版光刻/键合对准系统、基片热压键合/低温等离子键合系统、基片清洗机、基片检测系统、SOI 基片键合系统、基片临时键合/分离系统、纳米压印系统。

目前已有数千台设备安装在世界各地, 被广泛地应用于 MEMS 微机电系统/微流体器件, SOI 基片制造, 3D 封装, 纳米压印, 化合物半导体器件和功率器件等领域。

EVG610 是一款非常灵活的、适用于研发和小批量试产的对准系统, 可处理 zui 大 200mm 之内的各种规格的晶片。EVG610 支持各种标准的光刻工艺, 例如: 真空、软、硬接触和接近曝光; 也支持其他特殊的应用, 如键合对准、纳米压印光刻、微接触印刷等。EVG610 系统中的工具更换非常简便快捷, 每次更换都可在几分钟之内完成, 而不需要专门的工程人员和培训, 非常适合大学、研究所的科研实验和小批量生产。

二、应用范围

EVG 光刻机主要应用于半导体光电器件、功率器件、微波器件及微电子机械系统(MEMS)、硅片凸点、化合物半导体等领域, 涵盖了微纳电子领域微米或亚微米级线条器件的图形光刻

应用。

三、主要特点

- ◆ 支持背面对准光刻和键合对准工艺
- ◆ 自动的微米计控制曝光间距
- ◆ 自动契型补偿系统
- ◆ 优异的全局光强均匀度
- ◆ 免维护单独气浮工作台
- ◆ zui 小化的占地面积
- ◆ Windows 图形化用户界面
- ◆ 完善的多用户管理（用户权限、界面语言、菜单和工艺控制）

四、技术参数

衬底/晶片尺寸 (mm)		小片--200mm, 150mm*150mm, 0.1-10mm 厚度
掩膜板 zui 大尺寸		zui 大 9' *9'
物镜间距		8-30mm 连续可调
对准方式	上部对准, CCD	±0.5um
	上部对准, 目镜	可选
	底部对准	可选
	透过式红外对准	可选
	键合对准	可选
	原位对准校正	可选
工作台	精密微米计	手动
	载片台	真空吸盘式, 标配 4 寸, 可扩至 8 寸
	接触压力	5-80N 可调
曝光	方式	接近式, 软、硬、真空接触
	分辨率	接触式 < 0.8um, 接近式 ≥ 2um
	波长	350-450nm, 可选 200nm

	光强均匀性	$\leq 2\%$
	汞灯	350W, 500W
纳米压印光刻	硬压头	可选
	软压头	可选

亚科电子-设备咨询部:

18263262536/0632-5976067

欢迎您的来电咨询 !